

证券代码：920570

证券简称：坤博精工

公告编号：2026-045

## 浙江坤博精工科技股份有限公司

### 投资者关系活动记录表

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 一、投资者关系活动类别

- 特定对象调研
- 业绩说明会
- 媒体采访
- 现场参观
- 新闻发布会
- 分析师会议
- 路演活动
- 其他（线上会议）

#### 二、投资者关系活动情况

活动时间：2026年6月24日

活动地点：公司会议室

参会单位及人员：建信基金、创金合信基金、阳光资产、太平养老保险、长城财富资产、开源证券、民生证券、联储证券、浙商证券、长江证券、粤港澳大湾区共同家园发展基金、尚诚资产、明达资产、国晖投资、尚颀投资、顶天投资、青榕资产、前海再保险、一米资本、华能贵诚信托、鸿运私募基金、东方国际、点石成鑫资产、青创伯乐投资、Willing Capital、君茂资本

上市公司接待人员：董事长厉全明先生、董事会秘书厉康妮女士

### 三、 投资者关系活动主要内容

**问题 1：请问公司在半导体设备、核电、工业自动化（精密齿轮磨床/大型电动注塑机）等新拓展的业务领域收入进展？**

**回答：**公司半导体设备部件业务目前处于早期放量阶段，2025 年已实现小批量收入，产品主要覆盖碳化硅炉体、氟化炉体、物理沉积/化学沉积真空腔体等，客户验证进展顺利。该业务目前收入占比尚小（不足 7%），受益于半导体设备国产化推进，需求端将持续释放。

在核电检修装备部件业务方面，公司 2025 年度已完成检修真空腔、蒸发器减摩板的研发及相关检测。核电项目周期较长、订单确认节奏受客户投建进度影响，收入存在波动。

大型电动注塑机部件业务已在 2025 年形成批量销售，主要面向一些海外高端客户。精密齿轮磨床部件业务也已形成稳定销售，主要面向国内高端用户，目前处于市场拓展阶段。

精密成型零部件 2025 年度整体的毛利率为 29.36%，较上年同期增加 3.26%。

**问题 2：公司切入物流机器人领域并实现批量供货，并计划建设无尘车间加码半导体零部件。请问 2025 年物流机器人和半导体零部件业务分别实现了多少收入？主要客户是哪些？**

**回答：**公司半导体零部件业务 2025 年已形成小批量供货，但因目前收入规模相对较小（不足 2%），尚未达到单独列示的统计口径。物流机器人部件业务 2025 年度已形成稳定的批量供货能力，与下游客户建立了持续的合作关系。该业务正处于产能爬坡和市场拓展阶段，2025 年度收入占比尚小（不足 4%），目前订单交付节奏正常，后续收入规模会随客户放量逐步增长。

以上两类业务的客户群体主要是面向国内外相关行业的知名企业。

**问题 3：公司将光伏单晶硅生长真空炉技术迁移到半导体真空炉的路径是什么？**

**回答：**公司依托光伏单晶硅生长真空炉体精密焊接与成型工艺的技术积累，以碳化硅（SiC）长晶炉体为差异化切入点，通过升级氦气真空检漏、超高洁净度焊接及热场控制等半导体级工艺，并联合高校博士后工作站合作研发半导体装备关键材料与精密制造工艺，实现从光伏设备向半导体真空炉体的渐进式迁移与

产业链延伸。

**问题 4：公司“年产 900 套大型风电传动部件生产线”项目截至目前的进展如何？**

**回答：**截至 2025 年 12 月 31 日，该项目的投入进度为 88.33%。该项目的厂房改造、设备安装调试及试样工作已于 2025 年底前完成，采用行业领先的数控加工中心、自动化砂处理设备及高精度检测设备，能够大幅提升生产效率与产品精度。目前相关产品已试制成功，关键尺寸精度与内部质量均通过客户的技术认可，2026 年一季度已实现小批量供货。同时，公司正积极推进与客户的协同对接，预计后续可实现批量供货，为公司抢占大型化风电机组零部件市场份额奠定坚实基础。

**问题 5：2025 年真空炉体业务收入大幅萎缩，未来是否会调整方向针对半导体行业进行拓展？**

**回答：**受光伏行业供需失衡、产能出清周期影响，公司单晶硅生长真空炉体业务 2025 年度出现明显下滑。面对光伏行业周期性调整，公司也在积极优化业务结构。目前半导体装备部件业务已初具规模，产品逐步获得下游客户认可。在此基础上，公司将进一步挖掘客户深层需求，建立常态化的技术交流与市场洞察机制，精准把握下游客户在设备迭代、工艺升级及供应链安全方面的核心诉求。2026 年，公司将依托现有核心技术，规划建设“千级+万级”无尘恒温恒湿车间，用于半导体零部件的清洗、试装及真空无尘包装。项目建成后，公司将具备从精密加工到终端洁净交付的全流程闭环能力，有效填补当前后段处理缺口，进一步拓展半导体装备领域业务。

浙江坤博精工科技股份有限公司

董事会

2026 年 6 月 25 日